

# 酸铜光剂

## EONS

### 药浴组成及作业条件

| 名称  | 范围                   | 建议      | 消耗量         |
|-----|----------------------|---------|-------------|
| 硫酸铜 | 150~230g/L           | 200g/L  |             |
| 硫酸  | 50~90g/L             | 70g/L   |             |
| 氯离子 | 60~150mg/L           | 70mg/L  |             |
| M   | 4~8ml/L              | 5ml/L   | 10~20ml/KAH |
| A   | 0.4~0.7ml/L          | 0.5ml/L | 50~60ml/KAH |
| B   | 0.1~0.3ml/L          | 0.1ml/L | 40~60ml/KAH |
| 电流  | 1~5A/dm <sup>2</sup> |         |             |
| 浴温  | 25°C (20~40°C)       |         |             |
| 搅拌  | 强烈、均匀的空气搅拌           |         |             |
| 阳极  | 磷铜 (必须使用钛盐和阳极袋)      |         |             |

### 特性

清亮的高光泽镜面感，出光速度快，饱满度强以及走位延展性佳、颜色红润，氯离子的操作范围广、耐高温性强，不易针孔或起砂。

### 应用范围

适用于各种不同的基体金属、铁件、锌合金件，饰品、塑料件等同样适用。

### 铜和硫酸

当铜或硫酸的浓度太低时高电位容易产生树枝状和烧焦。

### 氯离子

太低时会造成整平不佳甚至产生麻点。氯离子补可使用氯化钠 (氯离子 1mg/L=1.7mg/L) 或盐酸 (分析纯 37%) 即氯离子 1mg/L=0.0023ml/L。

### 光剂

M 太少—>整体光泽整平不足，太多会出现白雾。

A 太少—>整体光泽会变弱，太多高区容易有树枝状。

B 太少—>高区光泽不良，过多低区光泽不良。

### 温度

最适合的温度为 25°C，温度越高光剂消耗量会增加。

### 搅拌

搅拌不充分容易产生烧焦。

### 过滤

连续过滤，使用活性炭会除去相当程度的光剂。

### 电流

必须以镀件的形状及作业条件等因素来决定；密度不同则镀层特性及光剂的消耗量会改变；密度低时镀层饱满度变差、内应力减少、硬度稍微提高。

### 管理方法

成分：平时分析硫酸铜和硫酸的成分，氯离子会随电解减少。

光剂：消耗量会因电流密度、温度、汲出等因素不同而影响。

活性炭处理后须再重建新浴或补充适量的光剂。

